**Питання до контрольної самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів заочної форми навчання спеціальностей радіоелектронної галузі** (**МК**)

1. Назвати три центри управління ОП на Україні. Які структури здійснюють державне управління ОП на Україні, їх функції?
2. Назвати три центри управління ОП на Україні. Сутність управління ОП на підприємстві зі сторони власника/адміністрації підприємства.
3. Назвати три центри управління ОП на Україні. Сутність управління ОП на підприємстві зі сторони робітників.
4. Система управління ОП (СУОП): визначення, концепція, функції, задачі, структура.
5. Гігієнічна класифікація праці. Класи умов характеру праці.
6. Організаційні заходи охорони праці при роботі в умовах дії ЕМП.
7. Технічні заходи захисту від ЕМП.
8. Індивідуальні засоби захисту від ЕМП.
9. Заходи охорони праці при експлуатації радіоелектронних пристроїв.
10. Заходи охорони праці при налагодженні і настройці передаючих пристроїв.
11. Охорона праці при радіомонтажних та складальних роботах.
12. Техніка безпеки при заготівельних роботах (штампування, різання).
13. Вимоги охорони праці при виготовленні печатних плат.
14. Техніка безпеки при нанесенні металевих, хімічних і лакофарбових покриттів на елементи і вузли РЕА.
15. Вимоги охорони праці щодо планування приміщень та розміщення обладнання при виготовленні РЕА.
16. Захист від статичної електрики, використання нейтралізаторів статичної електрики.
17. Захист радіоелектронного обладнання від грозової електрики.
18. Заходи безпеки при вимірюванні електричних параметрів.
19. Вимоги технічної естетики до РЕА, її вплив на поліпшення умов і безпеки праці.
20. Кондиціонування повітря у приміщеннях з виробництва РЕА.
21. Вимоги техніки безпеки при роботі з кислотами, лугами та небезпечними токсичними речовинами.
22. Заходи охорони праці при струминному, електролітичному травленні напівпровідникових матеріалів та їх обробці у травильних ваннах.
23. Вимоги техніки безпеки при утворенні структур методом дифузії та структур з електронно-дірчастими переходами методом сплавлення.
24. Забезпечення безпечності робіт при знежиренні, промиванні та сушінні напівпровідникових матеріалів.
25. Умови безпечного проведення робіт на водневих печах і вакуумних установках.
26. Техніка безпеки при герметизації напівпровідникових приладів.
27. Техніка безпеки під час механічних та кліматичних випробувань напівпровідникових приладів.
28. Техніка безпеки при нанесенні гальванічних покриттів, фарбуванні та маркуванні напівпровідникових приладів.
29. Вимоги охорони праці до робочих місць для виготовлення напівпровідникових приладів.
30. Улаштування та нормування місцевого освітлення на робочих місцях для виготовлення напівпровідникових приладів.
31. Підвищення ефективності засобів захисту: ізоляційного покриття, пристроїв захисного заземлення та занулення.
32. Підвищення ефективності засобів захисту: пристроїв захисного відключення, пристроїв блокування та сигналізації.
33. Підвищення ефективності засобів захисту: засобів індивідуального захисту, інструментів та приладів.
34. Безпечність праці при гальванічній обробці деталей та вузлів приладів.
35. Безпечність праці при паянні печатних плат радіоапаратури.
36. Причини виникнення пожеж в РЕА.
37. Захисні покриття від метеорологічного впливу.
38. ТБ при паянні деталей та вузлів РЕА.
39. ТБ при зварюванні деталей та вузлів РЕА.
40. ТБ при виготовленні деталей РЕА з пластмаси.
41. ТБ при виготовленні деталей РЕА з кераміки.
42. ТБ при виготовленні напівпровідникових приладів та інтегральних схем.
43. ТБ при виготовленні резисторів.
44. ТБ при виготовленні конденсаторів.
45. Кліматичні випробування приладів РЕА.